

Confidential

UJ **UI Science Profile**
Equipment for next generation

友藍サイエンス株式会社

Profile of UI SCIENCE

○社名 UI SCIENCE 주식회사

○本社住所 치바현 카시와시 타카타1059-5
電話 04-7137-7383 FAX 04-7137-7384

○会社概要

설립	2016年 9月
자본금	¥100,000,000円
거래은행	Chiba Bank
대표이사	우메모토 신이치

2019년 매출	¥1,000백만엔
장비납입대수	年12~14기

○판매장비종별

자동 웨이퍼도금장치
세미오토 웨이퍼도금장치
RtoR 커넥터도금장치
리드프레임 도금장치 단척R to R
렉방식기반 웨이퍼도금장치
각종도금지그 (몰드가공 실리콘마스크)



Introduction of UI SCIENCE

UI사이언스 장비컨셉

- 당사는, 20년 도금장치 기술을 축적한 도금장비 메이커 입니다.
- 당사의 장치는, 고객의 사양에 따라 당사의 기술을 탑재, 장비 및 시스템 설계를 하는 테일러 메이드 장치 입니다.
- 당사의 장치는, 높은 기술을 탑재하고, 설치 장소의 최소화를 고려한 장치입니다.
- 당사의, 장치설계는, 2D와3D, CAD 로 오더메이드에 대응하여 설계합니다..
- 당사는, 도금설계의 사양결정, 설계, 제조, 설치, 도금시작, 양산입회, 모든 것이 가능한 장치메이커 입니다.

조직체제

営業
經理、総務
半導体事業部
機械設計
生産管理
製造
システム制御

총인원15名



Access to UI SCIENCE

本社柏工場

〒277-0861 千葉県柏市高田1059-5

・1059-5 TAKATA KASHIWA CTIY CHIBA JAPAN

・TEL 04-7137-7383

最寄り駅までのアクセス

つくばエクスプレス/柏の葉キャンパス駅

東京駅から電車で35分

羽田空港から電車で60分

バスで75分

成田空港から電車で60分

バスで90分

野田七光台工場

最寄り駅までのアクセス

野田アーバンパークライン/川間駅

〒278-0051 千葉県野田市七光台187-1

本社柏工場

七光台工場



Introduction of Plating equipment.

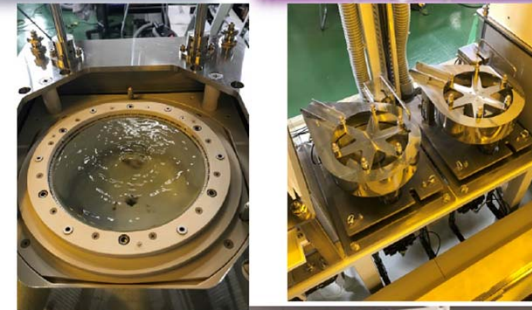
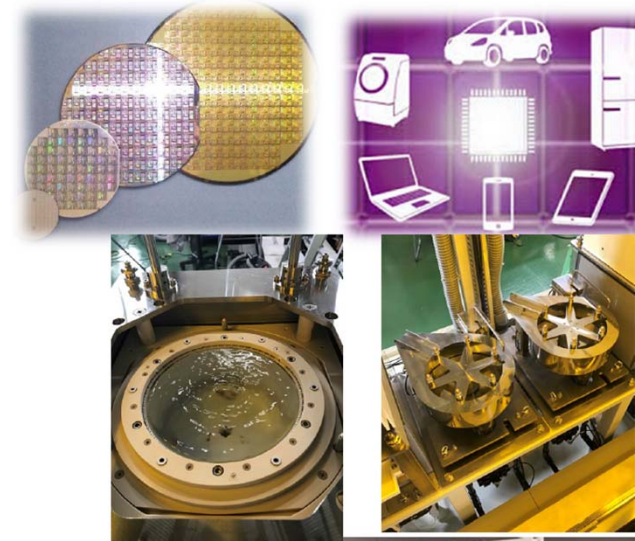
Confidential

전자동 웨이퍼 도금장치

모델명칭	: UIWA-04~08
도금컵수	: 4~8컵 (최대8컵)
생산매수	: 약 9000매/월 (Cu도금)
대상사이즈	: 3-4-5-6-8인치
기본처리사양	: Cu, Ni, Au, Sn
대상재질	: 실리콘웨이퍼 / GaAs웨이퍼 GaN 웨이퍼/기타 웨이퍼

○장치설계 컨셉트

- 스카라로봇 탑재로 안정 반송, 고품질 도금대응
- 더블핸들 스카라로봇 탑재로 웨이퍼 오염방지
- 생산레시피, 생산기록, 생산녹화기능탑재(SECS규격대응)
- 오리지널 페이스타운 컵방식으로 고품질 도금대응가능
- 웨이퍼 링 세정기능 탑재로, 고품질 도금대응
- 설치장소를 최소화 하는 설계컨셉트



(2018年Model 8inch-8cup-4SRD)

Introduction of Plating equipment.

Confidential

Cup Type 도금장치

- 모델명칭 : UIWM-01~014
- 도금컵수 : 1~14컵 (최대14컵)
- 생산매수 : 약9000매/월
- 대상사이즈 : 3-4-5-6-8인치
- 기본처리사양 : Cu, Ni, Au, Sn

8inch Cu 4+4+2



8inch Cu 8+6

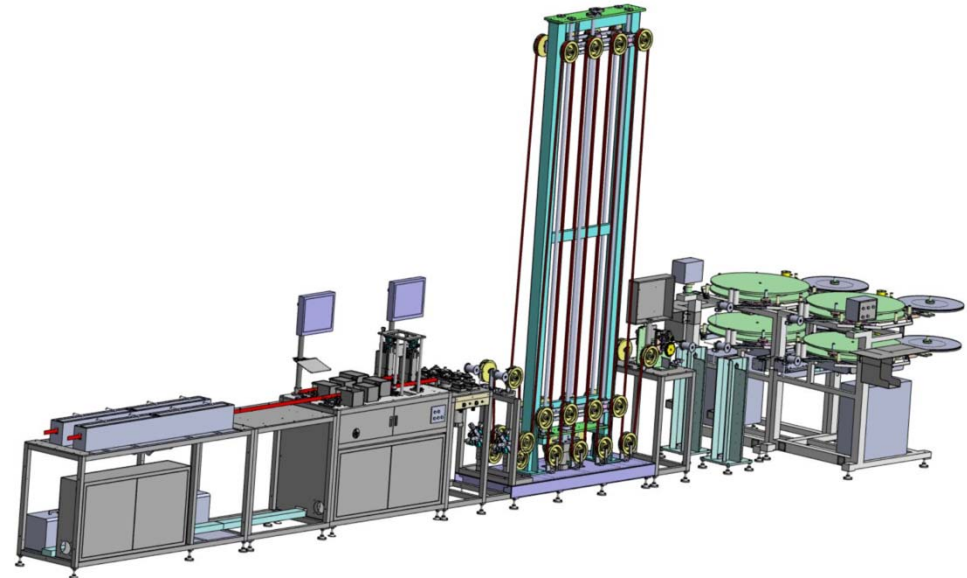


Introduction of Plating equipment.

Confidential

RtoR 커넥터/재료 부분도금장치

모델명칭	: UIRC-02 ~04
라인수	: 1조~4조(최대4조)
반송처리속도	: 1.0~25.0m/min
대상제품	: 커넥터 류, 또는 후프 류 : 두께 t0.06 ~ 2.0mm : 폭 5 ~ 120mm
기본처리사양	: 전면Ni+부분Pd+부분Au+부분Sn : 전면Cu+전면Sn+리플로우등
대상재질	: Cu 합금, SUS 등



○장치설계 컨셉트

- 마이크로 커넥터 제품을 안전반송, 고품질의 도금대응가능
- 차량용 커넥터 제품을 안전반송, 고품질의 도금대응가능
- 후프 제품을 안전반송, 고품질의 도금대응가능
- 각종 부분도금용 지그 가공으로 높은 정밀도에 대응가능
- 설치장소를 최소화하는 설계 컨셉트



Introduction of Plating equipment.

Confidential

리드프레임 도금장치

RtoR타입 부분도금장치

모델명칭	: UIRLF-02 ~04
라인수	: 2조~4조(최대4조)
반송처리속도	: 2.0~5.0m/min
대상제품	: Cu材 42AL材 他
기본처리사양	Cu, Ni, Ag, Au, Sn

○장치컨셉

- 오리지널 도금치구(몰드마스크 타입)로 고품질 도금 대응가능
- 스팟도금 위치정도 ± 0.07 이하 달성
- 설치 장소를 최소화 하는 설계컨셉
- 에너지효율, 메인テナンス 프리



Introduction of Plating equipment.

Confidential

리드프레임 도금장치

단척타입 부분도금장치

모델명칭	: UICLF - 04 or 06
라인수	: 4열(최대6열)
반송처리속도	: 1.6 ~ 2.0m/min
대상제품	: Cu材 42AL材 他
대응제품수치	폭 : 20 ~ 120 mm 길이 : 120 ~ 300 mm 두께 : 0.10 ~ 0.25 mm
기본처리사양	Cu, Ni, Ag, Au



○장치컨셉

- 오리지널 도금치구(몰드마스크 타입) 로 고품질 도금대응가능
- 스팟도금 위치정도±0.05이하 달성
- 매트릭스타입 리드프레임 대응가능
- 에너지효율, 메인テナンス 프리

Introduction of control system (A D L S)

Confidential

Auto data logging System

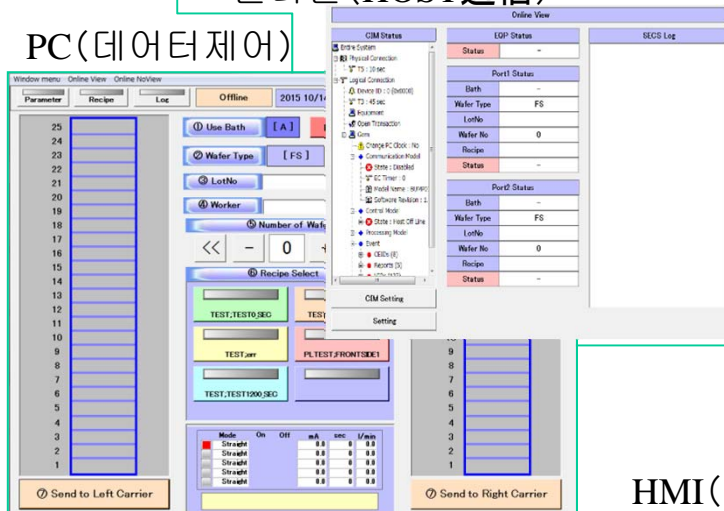


HOST서비
SECS/GEM

온라인 (HOST通信)

- 설비제어 (반송, 로봇제어 등)
- 레시피D/L, 데이터수집, 경보이력관리 (PC제어)
- 레시피U/L, 호스트통신관리 (온라인제어)

PC (데이터제어)



PLC (설비제어)

PLC (설비제어)



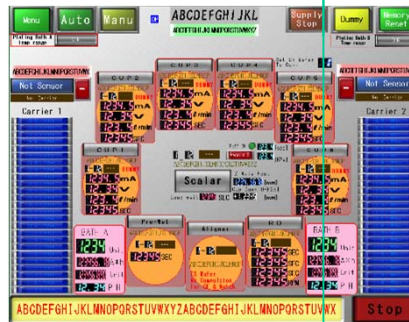
Melsecnet/H

라인간 통신

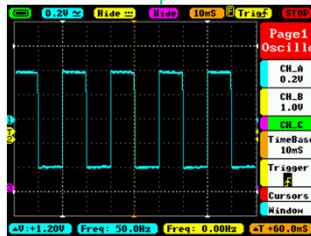
Ethernet

HMI (설비제어)

CC-Link
FA通信

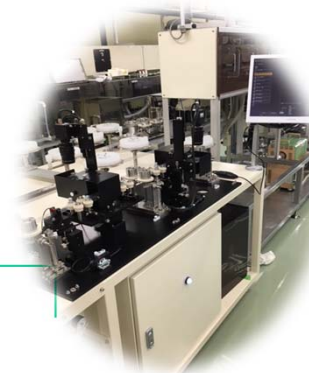


Ethernet



電流制御基板制御、噴流制御等

RS-232C通信



범용화상검사장치

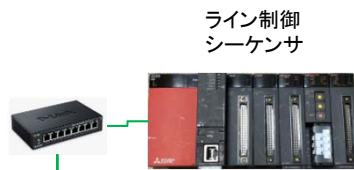
Ethernet

ADLS FA panel 6의 시스템구성

모바일 터치판넬 부속

칸반, 데이터 수집, 別室 모니터など、1用途毎に1台のPC(1クライアント)が必要になります

モバイルタッチパネル
(持ち運び 各機器の操作、パラメータ設定)



SECS/GEM

オフィス



現場への
カンバン表示

